**國立臺北教育大學 研究成果教師自行申請專利報備表**

**(※依專利法第七條規定，提案人之各專利案的專利申請權及專利權，皆屬本校所有；於自行申請專利時，請以『國立臺北教育大學』為唯一專利申請人或專利權人，並請務必持續維護專利權。)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **提案人**  **(發明人代表)** | 姓名及職稱： 提案單位(系/所/中心)： | | | |
| **計畫**  **合作機構** | (本申請案所屬之經費來源，如：科技部、經濟部、農委會等外部機構) | | | □利用本校資源**(無計畫)**  (所執行者為校內計畫，或無計畫) |
| **計畫名稱**  **及編號** | (衍生本申請案之所有計畫，並附核定清單或契約書影本) | | | **計畫主持人**  **簽章** |
| **計畫合作期限**  **及金額** | 自 年 月 日至 年 月 日；共新台幣 元整 | | | |
| **申請專利名稱** |  | | | |
| **擬申請之國家** | □中華民國 □美國 □其他： | | | |
| **自行申請專利理由** | ※請於完成專利申請程序後，主動提供專利申請書、專利說明書、專利申請日、專利申請號等資訊(可向事務所索取)。 | | | |
| **專利管理** | 擬(已)委任 (請填寫事務所名稱)撰稿、管理 | | | |
| **附 件**  **(＊為必要文件)** | □**＊**技術分類表；□**＊**研究成果專利發明人資料表；  □**＊**發明人專利申請權讓與同意書；□**＊**技術說明表(中、英文表單)；  □**＊**教師自行申請專利合約書(**一式兩份**)  □**＊**計畫經費核定清單(科技部計畫)或研究計畫補助合約書影本(非科技部計畫)  □**＊**專利申請書與專利說明書。 | | | |
| 提案人: (簽章) | | 提案日期 : 年 月 日 | | |
| 案件聯絡人(□同提案人)： 先生/小姐  電 話： | | | 單 位：  E-mail： | |
| 敬 陳  系(中心)主任/所長  院長/校級中心主任 | | | | |
| 研 發 處 (產學合作與職涯發展組)  研 發 長 | | | | |

**(後會)文書組**

**【請於兩份『教師自行申請專利合約書』)用完印後，送回產學合作與職涯發展組】**

**技術分類表**

**(請依技術本質勾選(可複選)或於其他(請自填)欄位填入適當類別)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一階 | 二階 | 三階 |
| 生醫  農健 | 農業 | □植物種苗□動物種苗□生物農藥□生物肥料□抗病/蟲/逆境性□生物整治□品種權□生物機電□組織培養□觀賞□發酵□基因轉殖□糧食□蔬菜□天然物利用□遺傳育種□森林學  □獸醫學□膳食補充劑與保健食品□其他(請自填) |
| 醫療  器材 | □診斷與監測用器材□體外診斷用器材□手術與治療用器材□輔助與彌補用器材其他類醫療器材□疼痛管理器材□低/非侵入性器材□預防疾病與健康促進之設備及用品□醫學影像分析□骨替代材□其他(請自填) |
| 篩選  平台 | □抗體□生物晶片□細胞分析□組合式分子生物□組合化學□高通量藥物篩選技術(HTS)  □蛋白酶□藥物篩選□標靶藥物□噬菌體展示技術□其他(請自填) |
| 藥物 | □止痛藥□麻醉劑□血管生成□消炎□抗生素□抗體□抗癌□抗真菌□antisense□抗病毒□細胞凋亡□細胞訊息□中樞神經系統□疾病模型□藥物輸送□生育□基因治療□賀爾蒙  □免疫治療□發炎□新陳代謝□天然物□病原體□胜肽□前驅藥物□蛋白質□RNAi□小分子藥物□疫苗□病毒□傷口癒合□美容□疼痛管理□疾病防治□幹細胞□保健食品□其他(請自填) |
| 基因  體學 | □allele□生物資訊學□cDNA□DNA□流行病學□EST□基因□基因型□homologue□isogene  □基因庫□微陣列/微陣列分析軟體□藥物基因體學□聚合酶□多型性□定位選殖□蛋白質體學□受體□RNA□標靶驗證□基因轉殖動物□其他(請自填) |
| 研究  工具 | □抗體□細胞株□色層分析□細胞培養□定向分子演化□DNA/RNA定序□DNA/RNA合成□電泳□酵素□裝置□表現系統□雜交□老鼠模式□寡核苷酸合成□PCR檢測□蛋白酶□蛋白質定序□蛋白質合成□試劑□RNAi□光譜□載體□蛋白質定量工具□其他(請自填) |
| 技術 | □抗體□生物晶片□顯影劑□DNA探針□造影成像□分子標記□放射性同位素□檢測技術  □純化/萃取□其他(請自填) |
| 電資  通光 | 電子  光電 | □光資訊技術□光電半導體技術□平面顯示技術□背光技術□軟性電子技術□光學技術(含鏡片材料)□電子及光電構裝技術□矽基半導體技術□電磁/光電訊號檢測□奈米電子技術  □電子元件散熱技術□其他(請自填) |
| 資訊  通訊 | □有線網路□語音□資訊安全□監控□網際網路電話相關技術(VoIP) □Web相關技術□智慧型資訊系統□無線通訊技術□射頻辨識技術及應用(RFID)□環境控制與感知技術□數位視/音訊與多媒體技術□光通訊技術□電子商務□嵌入式系統技術□異質整合系統、記憶體子系統□處理器架構、編譯器技術□GPU技術□其他(請自填) |
| 機能  材化 | 材料  化工 | □添加劑□觸媒□塗料/塗佈□電化學□石墨烯□導電高分子□塑料/聚合/複合材料□化學/生物分析□奈米材料□半導體材料/製程□物料改質□超導體□分散均勻化□光學薄膜□藥物製程□有機合成□純化/分離程序□鐵磁性材料□材料合成及精密成形□軟磁材料□鋼鐵材料□其他(請自填) |
| 能源  環工 | □替代/生質能源□燃料電池□化學/生物分析□高電功率□碳氫化合物□儲能□節能減碳□太陽能/電池□海洋工程□醫學/診斷/器械/儀器□環境整治□土木工程□水利工程□感測/量測方法/系統□生醫材料□其他(請自填) |
| 機械  儀設 | □機械元件/裝置/設備□分析儀器□光學/激光機器人□顯微技術□導航(GPS)□光譜儀□超音波□電腦輔助設計/檢測□圖像處理□環境感測/感應器□生理訊號感測□致動器□微機電/元件/系統□微控制□手機支援輔助系統□3D積層製造□其他(請自填) |
| 其他  (請自填) |  |  |

**國立臺北教育大學 研究成果專利發明人資料表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ※發明人欄位填寫說明：  (1)發明人超過五位時，請自行複製發明人欄位使用。  (2)發明人請填寫實際的發明人，參酌美國專利實務上的認定，所謂發明人必須是對發明概念之形成及至少一項申請專利範圍之標的有所貢獻之人，才能稱為發明人。美國專利法規定，若列名之發明人未有發明之事實，則不得取得專利；若發明人記載錯誤，且可證明有「欺瞞之意圖」，則此專利權無法主張權利（單純接受指示，依所設計之實驗完成實驗結果者、提出需求者、提出產品缺點者等無實質貢獻者，不能算是發明人）。  (3)未來收益分配之有功人員不限於此專利申請案所列之實際發明人。 | | | | | |
| 發明人 | | 1 | 姓名 | (中文/英文)英文姓名需與護照一致 | | | |
| 服務單位 | 請填寫成果產出當下之身分，若同時兼任2種身分者也請各別列出 | 職稱 |  | |
| e-mail |  | 電話 |  | |
| 2 | 姓名 | (中文/英文)英文姓名需與護照一致 | | | |
| 服務單位 | 請填寫成果產出當下之身分，若同時兼任2種身分者也請各別列出 | 職稱 |  | |
| e-mail |  | 電話 |  | |
| 3 | 姓名 | (中文/英文)英文姓名需與護照一致 | | | |
| 服務單位 | 請填寫成果產出當下之身分，若同時兼任2種身分者也請各別列出 | 職稱 |  | |
| e-mail |  | 電話 |  | |
| 4 | 姓名 | (中文/英文)英文姓名需與護照一致 | | | |
| 服務單位 | 請填寫成果產出當下之身分，若同時兼任2種身分者也請各別列出 | 職稱 |  | |
| e-mail |  | 電話 |  | |
| 5 | 姓名 | (中文/英文)英文姓名需與護照一致 | | | |
| 服務單位 | 請填寫成果產出當下之身分，若同時兼任2種身分者也請各別列出 | 職稱 |  | |
| e-mail |  | 電話 |  | |

**國立臺北教育大學 權益讓渡書**

(請填寫首頁之「申請專利名稱」，以下簡稱為「本技術」)之發明人等同意將其專利申請權讓與國立臺北教育大學，另由發明人 (任職單位 )擔任本技術之發明人代表(即提案人)，以就本技術進行下述事宜—

1. 代表發明人等向國立臺北教育大學提出並續行臨時專利申請案(Provisional Application)或各國之正式專利申請案的校內申請程序；
2. 代表發明人等依「國立臺北教育大學研究發展成果暨技術移轉管理要點」之相關規定，統籌及履行發明人等之義務，並行使發明人等之權利；
3. 代表支付、收受，並統籌分配發明人等之專利費用負擔與權益收入；
4. 代表發明人等就專利是否繼續申請或維護，表示意見。

發明人等亦同意仍將盡力配合及協助本技術之專利申請與推廣授權事務。

此致

國立臺北教育大學

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*發明人： | 1. (簽章) | 年 月 日 |
|  | |  |
|  | 2. (簽章) | 年 月 日 |
|  |  |  |
|  | 3. (簽章) | 年 月 日 |
|  |  |  |
|  | 4. (簽章) | 年 月 日 |
| (\*1.應簽署者包含亦列為發明人之提案人；2.本同意書所述之「發明人」，包含專利法中所稱之發明人、新型創作人，與設計人；3.如有需要，請自行增列)  中華民國 年 月 日 | | |

**(以下內容一頁為限，不可揭露關鍵技術內容；填表完成後請刪除此行)**

**請於此欄位填寫發明名稱**

請放任一代表照片或圖片

(不可揭露技術內容；如無代表照片或圖片提供，可刪除此方框)

**提案人：** OOO 教授

**單 位：** 國立臺北教育大學 OOO學系/研究所

**簡 歷：**(可列出相關連結，例如系所、研究室網頁)

**市場及需求:**

**技術摘要(含成果):**

**優勢:**

**競爭產品:**

**專利現況:**

(1)本技術已有相關專利 (中華民國專利申請號:XXXX；美國專利證號: XXX)。

(2)本研究團隊具有數十年研究經驗…

(3)其他…

**聯絡方式(請不用填):**

**北教大**產學合作暨育成中心

Tel: 02-6639-6688#82337, E-mail: anmigel@tea.ntue.edu.tw

**Title of Invention**

**(Below is limited to 1-page only; be careful not to disclose vital technology content. Please delete these words when the document is finished)**

An interesting **photo** related to your technology

(be careful not to disclose key technology)

**PI：** Prof. XXX

Department of XXX, National Taiwan University of Education.

**Experience:**

**Market Needs:**

**Our Technology:**

**Strength:**

**Competing Products:**

**Intellectual Properties:**

**Contact (do not need to fill out):**

Industry-Academia Cooperation and Incubation Center, NTUE

Tel: 02-6639-6688#82337, E-mail: iic@tea.ntue.edu.tw**國立臺北教育大學教師自行申請專利合約書(一式兩份)**

本校案號：

(由研發處填寫)

立合約書人：國立臺北教育大學（以下簡稱甲方）

(請填寫提案人姓名)（以下簡稱乙方）

乙方執行○○○(機關名稱)(下稱資助機關)補助專題研究計畫「○○○計畫」」（計畫編號：○○○）之**研發成果**「○○○」(下稱本成果)，**其智慧財產權屬甲方所有**，惟乙方經甲方同意得依○○國(國別)之專利法申請專利，約定下列條款，依誠實信用原則共同遵守：

1. 乙方將本成果**以甲方名義**(中國大陸地區專利案除外)自費辦理專利申請及維護事宜（下稱本專利）。乙方申請本專利後，與本專利有關之專利申請相關費用、技術移轉（或授權）、權益分配及其他相關事宜，應依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺北教育大學研究發展成果暨技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理，乙方應負協助之義務。
2. 乙方同意依資助機關之相關規定，對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務，**未經甲方事前書面同意，不終止專利申請或專利維護案，亦不將專利申請權或專利權授權他人利用，或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為**。

**乙方並同意若不願繼續申請或維護專利權時，應事先以書面通知甲方，**並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺北教育大學研究發展成果暨技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。

1. 如申請/維護的為中國大陸地區專利案，甲方得視需要要求乙方將專利申請權（或專利權）無條件讓與甲方，並應於接獲甲方通知後，於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜，且不得另行要求任何報酬。
2. 乙方明瞭並知悉，因本專利未呈報資助機關即自行終止維護而產生之任何賠償或追償作業，乙方同意負責賠償或辦理相關費用繳回之作業。

乙方如違反本合約及資助機關相關規定之情事，願承擔相關法令及契約責任；乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定，除應承擔一切法律責任外，甲方並得視情節輕重要求損害賠償。

1. 本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止，但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內，乙方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。
2. 本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。
3. 就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。
4. 本合約正本**一式二份**，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺北教育大學 （簽章）

代 表 人：陳慶和

地 址：10671 臺北市大安區和平東路2段134號

乙 方：○○○ （簽章）

任職單位：

地 址：提案人聯絡地址

中華民國 年 月 日